



## 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年8月14日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス  
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢  
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186  
四半期報告書提出予定日 2023年8月14日 配当支払開始予定日 ー  
四半期決算補足説明資料作成の有無： 無  
四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨)

### 1. 2024年3月期第1四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年6月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	52,261	20.5	7,113	△8.7	7,628	△25.2	4,346	△40.9
2023年3月期第1四半期	43,386	56.9	7,791	62.1	10,204	57.1	7,355	△18.9

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 10,367百万円 (△37.6%) 2023年3月期第1四半期 16,610百万円 (26.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	92.64	91.42
2023年3月期第1四半期	164.78	156.90

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第1四半期	460,520	257,512	41.0	4,026.68
2023年3月期	410,648	249,656	44.7	3,916.07

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 188,941百万円 2023年3月期 183,729百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	50.00	—	55.00	105.00
2024年3月期	—	—	—	—	—
2024年3月期（予想）	—	50.00	—	50.00	100.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	105,000	7.7	15,000	△12.1	13,500	△42.7	8,500	△46.8	180.80
通期	220,000	4.4	32,500	△7.3	30,000	△29.3	18,000	△39.4	382.88

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期1Q	47,016,567株	2023年3月期	47,011,067株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	94,305株	2023年3月期	94,305株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期1Q	46,916,822株	2023年3月期1Q	44,641,863株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経営環境については、欧米諸国では景気回復と並行するインフレの抑制のため政策金利上げが続いておりましたが、米国は先行きの経済成長鈍化を見越し、金利上げを徐々に抑制する見通しが報じられております。日本では経済正常化の方向へ進むことに加え、インバウンド消費回復などのプラス面がある一方、企業・個人ともに燃料・電力の価格上昇のマイナス影響を受けている状況です。中国は個人消費が比較的伸びているものの、輸出低迷の影響を受け工業生産が伸び悩んでいることもあり、金融緩和などの措置がとられている状況です。

為替相場は、対米ドルを中心に円高傾向が見られましたが、春以降円安方向に転じております。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体産業を中心に需要調整局面となり、高水準であった前年と比較して需要が低迷しております。半導体製造装置の需要も前年対比で大きく減少することが見込まれております。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や受託加工、及び半導体製造プロセス向けの各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）などは欧米顧客を中心に売上が伸び悩みました。一方、CVD-SiC製品や石英坩堝は出荷が伸び、他事業の売上減をカバーしました。

電子デバイス事業では、サーモモジュールが通信分野等で比較的堅調であったことに加え、パワー半導体用基板は、産業機器向けやEV（電気自動車）向けの販売を引き続き伸ばしております。

なお、経常利益は前年同期に営業外損益の為替差益が2,198百万円発生しましたが、当第1四半期連結累計期間の為替差益の発生が僅少であったことにより、前年同期比で減少しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は52,261百万円（前年同期比20.5%増）、営業利益は7,113百万円（前年同期比8.7%減）、経常利益は7,628百万円（前年同期比25.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,346百万円（前年同期比40.9%減）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

半導体全体の需要が在庫調整局面にあるなか、半導体製造装置の需要も欧米顧客を中心に厳しい状況にあります。当社の真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品や半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ）、部品洗浄サービスは、設備稼働率の低下、設備投資の抑制を背景として売上が減少しました。一方、マテリアル製品のうちCVD-SiC製品については受注残に対する出荷が継続し、売上を伸ばしております。また、石英坩堝については太陽光パネル製造メーカー向けの出荷が順調に伸びております。

この結果、当該事業の売上高は29,874百万円（前年同期比0.5%増）、営業利益は4,115百万円（前年同期比25.5%減）となりました。

#### (電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

主力のサーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けや自動車温調シート向けの販売を伸ばしました。

パワー半導体用基板は、DCB基板の販売が産業機械向け等で順調に伸びており、加えてAMB基板が中国のEV車向けを中心に堅調であり、全体でも大きく売上を伸ばしました。また、前第2四半期連結会計期間より連結化した株式会社大泉製作所のセンサの売上等が加算されております。

この結果、当該事業の売上高は16,565百万円（前年同期比98.4%増）、営業利益は3,424百万円（前年同期比54.8%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械は前年同期比で出荷が減少しました。一方、ソーブレードには前第2四半期連結会計期間より連結化した東洋刃物株式会社の売上等が加算されております。

当該事業の売上高は5,821百万円（前年同期比9.4%増）、営業損失は80百万円（前年同期は営業利益179百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ49,872百万円増加し、460,520百万円となりました。これは主に現金及び預金28,558百万円、有形固定資産14,837百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ42,016百万円増加し、203,008百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債25,000百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）18,572百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ7,855百万円増加し、257,512百万円となりました。これは主に利益剰余金1,765百万円、為替換算調整勘定3,268百万円、非支配株主持分2,645百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2023年5月15日の「2023年3月期決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	103,115	131,674
受取手形、売掛金及び契約資産	53,276	52,411
商品及び製品	12,059	13,588
仕掛品	13,505	13,375
原材料及び貯蔵品	23,613	26,432
その他	9,955	11,692
貸倒引当金	△184	△210
流動資産合計	215,341	248,963
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	38,080	39,197
機械装置及び運搬具（純額）	44,171	45,960
工具、器具及び備品（純額）	5,984	6,134
土地	4,451	4,762
リース資産（純額）	11,009	11,013
建設仮勘定	35,913	47,380
有形固定資産合計	139,610	154,447
無形固定資産		
のれん	2,304	2,249
その他	4,645	4,511
無形固定資産合計	6,949	6,761
投資その他の資産		
関係会社株式	33,893	34,736
その他	15,489	16,261
貸倒引当金	△636	△651
投資その他の資産合計	48,745	50,347
固定資産合計	195,306	211,557
資産合計	410,648	460,520

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	40,524	37,546
電子記録債務	3,372	3,407
短期借入金	20,378	23,788
1年内償還予定の社債	4,723	4,498
1年内返済予定の長期借入金	11,102	14,727
未払法人税等	2,432	2,289
賞与引当金	2,913	2,855
その他	25,847	23,214
流動負債合計	111,294	112,326
固定負債		
社債	4,083	4,083
転換社債型新株予約権付社債	—	25,000
長期借入金	26,432	41,380
退職給付に係る負債	2,020	1,883
役員退職慰労引当金	—	81
資産除去債務	348	385
その他	16,812	17,867
固定負債合計	49,697	90,681
負債合計	160,991	203,008
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,425	29,429
資本剰余金	67,961	67,959
利益剰余金	69,656	71,422
自己株式	△88	△88
株主資本合計	166,955	168,723
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	272	384
為替換算調整勘定	16,477	19,746
退職給付に係る調整累計額	23	87
その他の包括利益累計額合計	16,773	20,217
新株予約権	40	38
非支配株主持分	65,887	68,532
純資産合計	249,656	257,512
負債純資産合計	410,648	460,520

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	43,386	52,261
売上原価	27,694	34,637
売上総利益	15,691	17,623
販売費及び一般管理費	7,900	10,510
営業利益	7,791	7,113
営業外収益		
受取利息	306	406
補助金収入	220	642
為替差益	2,198	142
その他	162	338
営業外収益合計	2,887	1,530
営業外費用		
支払利息	196	383
持分法による投資損失	195	465
その他	82	166
営業外費用合計	475	1,015
経常利益	10,204	7,628
特別利益		
持分変動利益	314	13
特別利益合計	314	13
特別損失		
固定資産処分損	86	—
投資有価証券評価損	—	489
特別損失合計	86	489
税金等調整前四半期純利益	10,431	7,152
法人税等	2,426	1,638
四半期純利益	8,005	5,514
非支配株主に帰属する四半期純利益	649	1,167
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,355	4,346



## (四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	8,005	5,514
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△149	112
為替換算調整勘定	6,483	3,931
退職給付に係る調整額	4	63
持分法適用会社に対する持分相当額	2,265	746
その他の包括利益合計	8,604	4,853
四半期包括利益	16,610	10,367
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,635	7,790
非支配株主に係る四半期包括利益	2,974	2,576

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	29,717	8,348	38,066	5,320	43,386	—	43,386
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	29,717	8,348	38,066	5,320	43,386	—	43,386
セグメント利益	5,524	2,212	7,737	179	7,916	△125	7,791

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△125百万円には、セグメント間取引の消去△131百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用256百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	29,874	16,565	46,440	5,821	52,261	—	52,261
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	29,874	16,565	46,440	5,821	52,261	—	52,261
セグメント利益 又は損失(△)	4,115	3,424	7,540	△80	7,460	△346	7,113

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△346百万円には、セグメント間取引の消去250百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用96百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。